

電子元器件及電晶體製造業促進計畫 (SPECS)

1. 背景

政府高度重視電子硬體製造，因為它是印度政府“印度製造”和“數位印度”計畫的重要支柱之一。印度的電子製造業現時面臨著8-10%的殘疾，與電子製造業不同部門以及價值鏈不同階段的競爭經濟體相比。

1.2 過去幾年，國內電子產品製造業大幅增長，正穩步從半淘汰（SKD）水准向完全淘汰（CKD）水准轉變。然而，國內附加值仍然很低，僅在10-30%之間。這是由於國家電子元器件製造生態系統的缺失、電晶體製造生態系統的近乎缺失和顯示器製造生態系統的缺失。國內電子製造業主要增長是進口電子元器件/分總成/零部件的成品組裝，主要滿足國內需求。

1.3 發展供應鏈是製造高附加值電子產品的關鍵。2019年2月25日公佈的2019年國家電子政策（NPE 2019）願景是，通過鼓勵和推動印度發展核心部件（包括晶片組）的能力，將印度定位為電子系統設計和製造（ESDM）的全球樞紐，為該行業創造一個有利於全球競爭的環境。

1.4 電子元件和電晶體的製造是資本密集型的，必須應對不斷變化的科技。零部件是電子產品的覈心，是物料清單（BOM）總價值的重要組成部分。一個充滿活力的電子元件製造生態系統對於印度電子製造業的整體長期和永續增長以及實現國際收支淨正平衡至關重要。

1.5 吸引投資製造電子元件/電晶體的主要障礙包括“零”關稅進口，因為大多數電子元件/電晶體都在世貿組織《信息技術協定》（ITA-1）的範圍內；建立具有競爭力的全球規模能力所需的高資本成本；基礎設施不足；缺乏充足、可靠和高品質的電力以及具有競爭力的供水；缺乏供應鏈；物流成本高；缺乏科技等。

1.6 修改後的特別激勵計畫（M-SIPS）旨在提供財政激勵，幫助抵消殘疾和高昂的前期成本，從而吸引電子製造業的投資。該計畫開放至2018年12月31日，接受新項目和擴建項目的申請。該計畫為投資電子製造設施的資本支出提供補貼（經濟特區組織占20%，非經濟特區組織占25%）。（M-SIPS）在促進印度電子製造業投資方面發揮了重要作用。

2. 電子元器件及電晶體製造業促進計畫（SPECS）

2.1 根據《促進電子元件和半導體制造計劃》（SPECS），擬按構成電子產品供應鏈的附表，提供25%資本支出的財政激勵，用於製造商品。

3. 目標

3.1 該計畫將有助於抵消國內零部件和電晶體製造業的殘疾，以加強該國的電子製造生態系統。

4. 資格

4.1 SPECS將適用於對新裝置的投資，以及擴大現有裝置的能力/現代化和多樣化。

W-18/30/2019-IPHW-MeitY

電子資訊技術部

(IPHW 部門)

5. 閾值限制

5.1 附加了符合該計畫要求的最低門檻投資.

5.2 新機組或擴容/現代化和現有機組多樣化的門檻相同。。

5.3 對於提供激勵措施的貨物/閾值清單的變更（如有），將進行定期審查..

6. 計畫的任期

6.1 SPECS將自通知之日起3年內開放申請。本計畫所接獲的申請將持續評估，並會按照本計畫所給予的準予繼續實施.

7. 該計畫下的激勵措施

7.1 對按附表所列貨物投資組織，給予資本性支出25%的獎勵。獎勵將在報帳的基礎上提供。

7.2 資本支出將是工廠、機械、設備、相關公用設施和科技（包括研發）的總支出。這些合格資本支出的詳細情況將列入準則。翻新廠房、機械和設備（包括相關公用設施和研發）的總價值，無論是進口的還是國內採購的，不超過總合格廠房、機械和設備（包括相關公用設施和研發）的20%，應考慮計算這方面的激勵.

7.3 州政府或其任何機構或地方機構提供的激勵（如有）應超過擬議方案中的合格激勵。

7.4 申請人也有資格根據印度政府的任何其他計畫領取福利。然而，申請人在（M-SIPS）計畫下承諾的投資，如已申請獎勵，則不符合SPECS計畫下的合格投資資格。

8. 準予和支付流程

8.1 任何在印度注册的實體均可根據該計畫提出申請。

8.2 每一項申請都將被視為新的投資，並將被視為一項獨立的申請。申請只適用於單期工程，本計畫不考慮分期申請。對任何申請人提出多個申請和/或多個地點沒有限制。

8.3 一份在各方面均已完成並在計畫到期日前提交的初步申請，將持續評估，並考慮準予。

8.4 本計畫下的獎勵將自申請確認之日起生效。確認書將在對申請進行初步審查後發出。對申請的確認不應解釋為根據SPECS準予

8.5 獎勵將在收到申請之日起5年內用於投資。

8.6 對符合條件的資本性支出的獎勵，經申請準予後予以釋放，但資本性支出超過門檻值的，開始商業化生產。隨後的獎勵索賠可每六個月提交一次。

W-18/30/2019-IPHW-MeitY

電子資訊技術部

(IPHW 部門)

8.7 根據規範獲得激勵的組織必須在商業生產中至少保留3（三）年，從開始生產之日起，或從收到上次激勵之日起1（一）年，以較晚者為準。

9. 治理機制

9.1 該計畫將通過一個節點機構實施。節點機構將對申請進行評估。

9.2 該節點機構將作為專案管理機構（PMA），負責提供秘書、管理和實施支持，並執行（MeitY）不時指派的其他職責。PMA的功能和責任將在MeitY單獨發佈的計畫指南中詳細說明。

9.3 為開展與實施SPECS有關的活動，PMA將特別：

9.3.1 接收申請，發出確認書，完成評估，並核實申請人是否符合本計畫的資助資格。

9.3.2 稽核報帳申請，並將獎金發放給準予的申請人。

9.3.3 定期向MeitY提交計畫進度和執行情況的報告。

9.4 PMA將把經評估合格的申請提交給由電子和資訊技術部（MeitY）組成的執行委員會（EC）。執行委員會將由一名不低於聯合秘書（MeitY）職級的官員主持。執行委員會將由有關部委和組織的代表組成。執行委員會的詳細組成、職能和責任將在方案準則中詳細闡述。

9.5 EC將建議PMA準予/拒絕/修改申請。根據EC的建議，PMA應向申請人發出準予函，並將副本發送給MeitY。

W-18/30/2019-IPHW-MeitY

電子資訊技術部

(IPHW 部門)

9.6 (MeitY) 須就支付獎勵予已獲批准的計畫項目的預算撥款。獎勵的發放應由PMA根據準予條件和其財務規則進行PMA將定期將預算要求作為合併金額提交給MeitY，而不是逐項提交。

9.7該計畫的進展將通過一個理事會 (GC) 進行審查，理事會由 (MeitY) 組成，由秘書長MeitY擔任主席。(GC) 將由來自政府和行業的專家組成 (GC) 將定期審查該計畫及其項目的進展情況。(GC) 將被授權不時對計畫指南進行修訂，以成功實施計畫。GC的詳細的組織、職能和責任將在方案指南中詳細闡述。

9.8理事會應不時審查和修訂符合本計畫激勵條件的貨物清單以及適用的門檻。

9.9為了使 (SPECS) 計畫有效運作，MeitY應製定一套評估和支付指南，並單獨發佈。

9.10對該方案進行中期評估，以評估工業和經濟根據既定目標所獲得的效益

符合SPECS激勵條件的貨物清單。

A. 最低投資限額為5000萬盧比的貨物清單。

序號	貨物說明
1.	SMT組件，包括LED晶片。
1.	智慧卡晶片模塊，RFID天線和標籤，CoB/系統封裝。
2.	電子用無源元件，包括電阻器、電容器、鐵氧體等。

W-18/30/2019-IPHW-MeitY

電子資訊技術部

(IPHW 部門)

3.	電子應用的機電元件，包括變壓器、電感器、線圈、繼電器、開關、微型電機、步進電機、無刷直流電機、連接器、散熱器、天線、揚聲器、麥克風等。
4.	電子設備用磁控管、波導、環行器、耦合器、隔離器、濾波器、磁鐵、射頻元件。
5.	印刷電路板，印刷電路板層板，預處理，光聚合膜，印刷電路板油墨；印刷柔性電子產品。
6.	電子應用的感測器、感測器、驅動器和晶體。
7.	攝像機模塊，可控震源電機/振鈴器。
8.	USB/數據線，HDMI線。
9.	SPECS下所有貨物的資本貨物。

B. 最低投資限額為15000萬盧比的貨物清單。

序號	貨物說明
1.	活性成分： a. 分立半導體器件，包括電晶體、二極體等。 b. 功率電晶體，包括場效應電晶體、mosfet、晶閘管等。
2.	石英和光纖預製件
3.	顯示幕總成和觸控式螢幕/蓋玻璃總成

C. 最低投資限額為25000萬盧比的貨物清單。

序號	貨物說明
1.	微型/納米電子元件，如微型機電系統（MEMS）和納米機電系統（NEMS）
2.	裝配、測試、標記和包裝（ATMP）單元

D. 最低投資限額為75000萬盧比的貨物清單。

W-18/30/2019-IPHW-MeitY

電子資訊技術部

(IPHW 部門)

序號	貨物說明
1.	電子機械（塑膠和金屬零件）

E. 最低投資限額為25億盧比的貨物清單

序號	貨物說明
1.	氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）、砷化鎵（GaAs）等複合電晶體和矽光電器件/集成電路、光電子器件

F. 最低投資限額為50億盧比的貨物清單

序號	貨物說明
1.	電晶體晶片

G. 最低投資限額為100億盧比的貨物清單

序號	貨物說明
1.	電晶體集成晶片（IC），包括邏輯[微處理器、微控制器、數位信號處理器（DSP）、專用集成電路（ASIC）等]；記憶體；類比/混合訊號IC等。
2.	用於電子應用的顯示器製造單元，包括液晶顯示器（LCD）、發光二極體（LED）、有機發光二極體（OLED）等。
